

智慧財產管理計畫與執行成果報告

一、 研發理念與策略

面對經營環境日益艱難的挑戰，本公司採取因應對策，經營策略上以「傳統 IC 封裝及 Sensor IC 封裝」齊步並重，為強化成本、產品、節能環保及滿足客戶需求，進行研發布局，期能透過研發創新，降低成本，建立未來發展所需技術，提升公司整體競爭力，並達成公司成長與永續經營的願景。

二、 智慧財產管理策略與目標

1. 智財策略

為提升本公司智財管理，並與公司營運雙主軸策略相互結合，以「持續精進智慧財產取得、保護、維護與運用等管理系統與措施」為本公司現階段之智財策略。

2. 智財政策與目標

透過風險機會識別分析後，訂定智財發展之政策與目標：

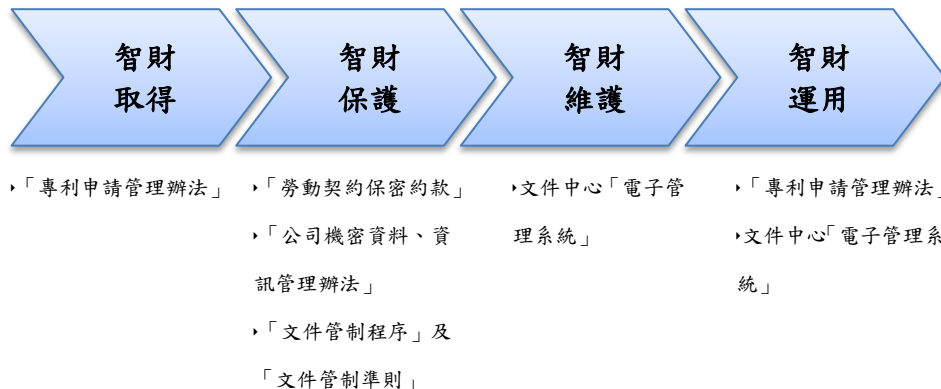
「強化各項技術之專利布局與維護」

「確保公司研發成果，提升產品競爭力和獲利」。

三、 智慧財產管理制度與資源運用

1. 智慧財產管理制度

本公司為提升智財管理並與經營發展之策略相互結合，訂定與營運目標連結之智慧財產管理計畫，強化智慧財產取得、保護、維護及運用等管理措施，降低營運風險，維持長期競爭力。建立如下之智慧財產管理制度：



(1) 專利管理制度

A. 訂定「專利申請管理辦法」

本公司由研發工程處負責專利權之管理，內部訂有「專利申請管理辦法」，作為專利之提案構想、申請、保護、維護及運用流程之遵循規範。

本公司之專利主要布局在各種封裝測試技術和電子製造服務技術，鼓勵朝公司未來產業發展方向申請專利，以發明專利為申請主軸。

B. 建置「專利總表」

定期更新及維護「專利總表」，搭配內部稽核及管理審查等機制，確保系統運作，達成智慧財產管理目標，並持續精進。

C. 獎勵措施

為了鼓勵員工積極創新，本公司建立獎勵制度，針對「創新提案」、「專利申請」、「特殊貢獻」等面向進行獎勵，結合公司智慧財產權之策略運用，為公司創造出具有高度價值之智慧財產。

(2) 營業秘密管理制度

A. 於員工管理方面，公司與員工間訂勞動契約保密約款，包含 新進員工：聘僱合約書、保密合約書

離職員工：離職返還資料義務及保密義務等

B. 於資訊管理方面，推行營業秘密管理相關規範，包含

▸ 訂定「文件管制程序」及「文件管制準則」

本公司訂有「文件管制程序」及「文件管制準則」，作為內部技術性、包含客戶端之營業秘密層級、使用方式及管理之遵循規範。

透過文件機密等級分類之建立及電子管理系統，管制與管理機密文件，以防止公司營業秘密外流。

▸ 訂定「公司機密資料、資訊管理辦法」

針對資訊安全，本公司則訂有「公司機密資料、資訊管理辦法」等資安管理相關規範，保障人員資料隱私與客戶權益，降低公司資訊不當外洩之風險。

C. 教育訓練與宣導

本公司已建置營業秘密管理規章制度，將營業秘密保護之議題納入新進人員之訓練課程，透過教育訓練與宣導，強化同仁保護公司機密資訊之意識以及法令遵循的專業認知，務求員工恪

遵保密義務，降低公司資訊不當外洩之風險。

2. 智慧財產管理資源運用

(1) 研發策略與方向

本公司現階段之研發策略，研發資源主要聚焦於發展傳統 IC 封裝及 Sensor IC 封裝之雙主軸策略上，進行核心能力規劃，期能深耕封裝技術，永續發展。

A. 研發組織

(a) 研發職能

- 創新產品開發研究，並以綠能、環保、節能產品為開發基礎。
- 產品製程改善、品質良率提升。

(2) 公司研發資源

▸ 歷年研發費用及占比

單位：新台幣仟元；%

年度	111 年度	110 年度	109 年度
研發費用	131,024	143,554	138,918
佔營收比 (%)	3	2	3

(3) 外部研發資源

近年來為了增加研發的深廣度，本公司積極參與政府補助項目之封裝技術研發計畫，如下說明：

期間	計畫名稱	內容	應用
101/9/01 至 103/8/31	車用大電流高電壓 IGBT 功率模組封裝技術開發計畫(車電關鍵技術計畫)	本公司接受政府補助項目之技術包括功率模組封裝設計、封裝技術和測試驗證技術。	大電流高電壓 IGBT 功率模組為電動車與油電混合車之關鍵零組件，可應用於車輛、船舶、太陽電池和風力發電產業。
104/12/01 至 106/11/30	高值化高功率半導體碳化矽功率模組計畫	本公司接受政府補助項目之技術包括功率模組封裝設計、封裝技術和測試驗證技術。	碳化矽元件可降低矽元件 85% 的切換損失，透過電力電子技術，可大幅改善能源轉換效能，是能源短缺和工業設備節能未來的首選，市場從資訊/消費性到工業用產品，廣泛應用於節能、高頻和高溫電力電子系統。
108/04/01 至 109/09/30	封測聯盟智慧製造與應用服務發展計畫	本公司接受政府補助項目之技術主要為感測器封裝肇因分析與回饋設備自動組態技術開發。	1. 透過聯網、數據採集、智能化分析達「智慧製造」與應用服務。 2. 促使製造良率提升，優化工廠生產管理。

四、 智慧財產之主要用途與貢獻

1. 保護運用研發成果，並運用於生產產品上，促進產品營收。
2. 加強保護營業秘密，避免洩漏營業秘密。

五、 智慧財產相關風險或機會與應對措施

1. 智財風險識別

本公司已考量影響智慧財產管理系統之內外部議題及利害關係人，關注並評估利害關係人對智慧財產管理制度之要求與期待，盤點結果如下：與本公司智慧財產管理制度有關的利害關係人，以客戶、投資人、員工和主管機關為主。

客戶重視符合產業發展需求之技術；投資人注重內控及運用公司智財成果，創造營收利益；員工需要智財教育訓練和提高智財認知；主管機關強調企業負責、創新、鼓勵推動實施智財管理制度，鏈結產/官/學/研發，活絡產業與帶動轉型。

2. 智財風險應對

利害關係人	內/外部議題	風險/機會	應對作法
客戶	●符合需求之技術	機會	依產業技術發展趨勢，檢視相關技術之專利申請狀況，並持續推動專利提案
投資人	●投資效益	機會	注重內控及運用公司智財成果，創造營收利益
員工	●研發成果/營業秘密保護 ●智財外流	機會 風險	透過智財教育訓練，提高智財認知 完善智財管理制度 建立機密保護機制
主管機關	●強化智財保護意識 ●避免侵權	機會 風險	完善智財管理制度

六、 規劃及實施持續改善機制，確保智財管理制度運作與成效

本公司每年至少一次將智慧財產管理計畫及執行情形，諸如專利申請及維持狀況、營業秘密保護狀況等事項向董事會進行報告。

為確保本公司所推動之智慧財產管理制度的運作符合組織預期，並持續改善及進行各項流程變更與補強作業，以達管理成效。

七、 112 年智慧財產執行成果

(1) 專利佈局成果

本公司專利主要布局在各種封裝測試技術和電子製造服務技術，統計截至 112 年第三季，本公司已向台灣、美國、中國、日本及歐洲等地區提出專利申請案，本公司取得之專利之統計資料如下：(1) 已註冊：55 件 (2) 申請中：4 件

(2) 其他

- (1) 研發主管每年亦至少一次於董事會報告研發現狀及未來研發計畫，使董事能適度了解本公司智慧財產權之布局。
- (2) 重視源頭管理，與員工簽訂保密合約，落實智慧財產管理。
- (3) 內部文件電子管制系統更新，強化智慧財產管理。
- (4) 對現職同仁進行專利與營業秘密專題之意識宣導。
- (5) 已訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」，規範董事及員工禁止洩漏商業機密及智慧財產權。

本公司每年至少一次將上述智慧財產管理計畫及執行情形向董事會進行報告，並針對董事之建議提出改善措施。最近一次提報日期為 112 年 11 月 6 日。